

変更通知書: TWELITE DIP 基板の変更(20240531)

承認: Seigo(成吾) Okumura(奥村) 31 May 2024

概要

TWELITE DIP を構成する DIP 変換基板の設計や調達先を変更します。

対象

次のTWELITE DIP シリーズ製品を対象としています。

製品	シリーズ	バリエーション	型番
TWELITE DIP	BLUE	マッチ棒アンテナ/ピン実装済み	TWE-L-DI-W
		マッチ棒アンテナ/ピン未実装	TWE-L-DP-W
	RED	マッチ棒アンテナ/ピン実装済み	MW-R-DI-W
		マッチ棒アンテナ/ピン未実装	MW-R-DP-W
	BLUE	同軸コネクタ/ピン実装済み	TWE-L-DI-U
		同軸コネクタ/ピン未実装	TWE-L-DP-U
	RED	同軸コネクタ/ピン実装済み	MW-R-DI-U
		同軸コネクタ/ピン未実装	MW-R-DP-U

内容

DIP 変換基板に対する変更内容を次に列挙します。

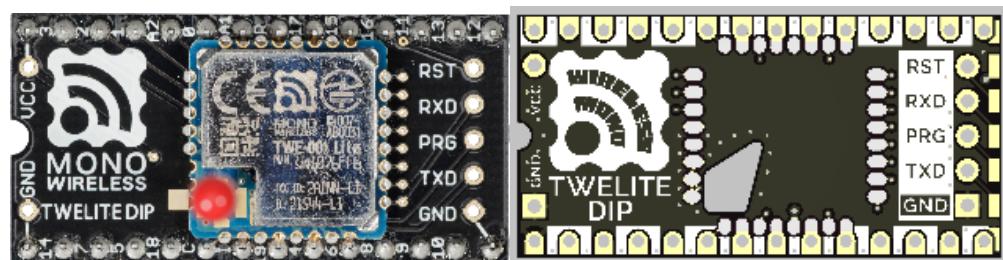
- ワイヤアンテナを実装するための開口部を拡張します
- 基板の構成を2層から4層へ変更し、1層と4層の大半をベタ GND とします
- 配線パターンを変更します
- TWELITE R3(型番: MW-LITER3) 互換の 7P インタフェース用拡張パッド(要ユーザ実装)を追加します
- シルクスクリーン印刷の意匠を変更します
- 基板の外形寸法をごく僅かに変更します

	旧	新
幅	35.56mm	35.56mm
奥行	17.78mm	17.8mm
ピン穴のピッチ	2.54mm	2.54mm
ピン穴の幅	15.24mm	15.4mm (*1)
ピン穴の径	φ0.8	φ0.9
ピンの種類	0.5mm角	0.5mm角

(*1) ピン実装済みの製品(型番: **DI*)では、15.24mm幅のソケットを想定し、先端部が15.24mmに合うようにピンのはんだ付けを行います

- 基板の調達先を変更します

参考として、基板の外観イメージを次に示します(左:変更前の写真、右:変更後の基板デザイン)。



想定される影響

製品の機能に変更はありません。また、無線性能は旧版と変わりません(当社測定値に基づく)。

目的

生産性の向上によるコスト削減のため。

時期

2024年6月以降の生産分から順次切り替え(ロットにより混在する可能性があります)。

関連情報

搭載するモジュール本体については、別の変更通知があります。
「変更通知書:TWELITE モジュール 表面刻印の変更」をご覧ください。
なお、本書に記載の変更と、上記の変更通知書における変更は前後する可能性があります。